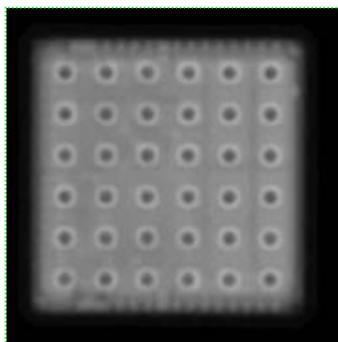
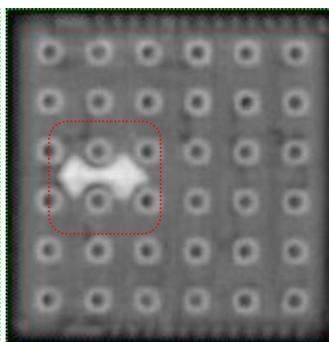


実装異常品の解析事例

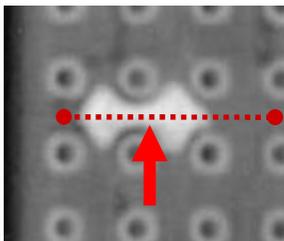
<超音波探傷装置によるP K G内部の密着度観察>



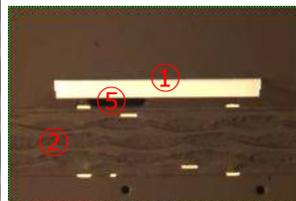
<正常品>



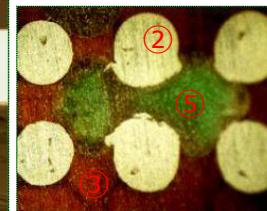
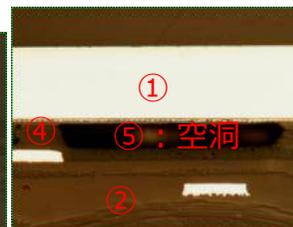
<異常品>



<断面研磨方向>



<基板の断面研磨>



<基板の平面研磨>

- ①. 4°レットチップ
- ②. P K Gのボール端子
- ③. 基板
- ④. アンダーフィル
- ⑤. 故障箇所（ボイドの発生）

■ P K G品を実装基盤に搭載後、観察画像において「異常」が観察された。
この原因を特定するため、観察画像の結果より、故障部位の「平面研磨」及び、「断面研磨」を行い、原因の特定を行った事例である。